

1. 마케팅/상품기획		
	마케팅	- RF IC, Camera Module, PMIC, Connectivity, Set 상품기획, 브랜드 전략 - Smartcard(Banking/Certification), Secure Storage and Authentication
	상품기획	- SOC(Multimedia, Memory, GNSS) - Camera module, Automotive, Mixed Signal
	CSE	- Modem RF/Telephony, AP SW, GNSS 기술 지원 경험자 - AP ISP 튜닝, CIS 튜닝 전문가
2. SOC 분야		
	Modem System	- RF IC 와 Baseband 제어블록(Filter, AGC, AFC, PN Model) 설계 전문가, Connectivity 알고리즘
	Modem Protocol	- 3GPP 표준 SW 개발 경험자
	RF	- Cellular/Connectivity RF 전문가, Analog(SM, ADC, PLL) 설계 전문가
	Application Processor	- IP 설계전문가 (Connectivity, Modem H/W, Audio, Multimedia, High Speed Serdes) - DFT, Debug, Verification, PI/SI, Reference Board 설계
	Architecture	- ModAP, Multimedia, Power, Connectivity 분야
	Software	- Embedded OS, Compiler, Telephony, SQE, Audio, Camera, GNSS
3. LSI 분야		
	CMOS Image센서	- Sensor Analog 설계전문가(CDS/DBS등), ISP, Lens, Module, 평가, 튜닝
	Display Driver IC	- Logic설계(I/F, T-Con, Low Power), - Analog설계 (LDO, 소스 감마/채널, DC-DC Converter, Regulator, Noise제거,고속 I/F) - Touch 설계(TSP, Analog설계) 및 FAE
	지문인식 IC	- 지문인식 S/W, H/W 개발 리더
	PMIC	- Architect - Analog설계 (Multi-Phase Switching regulator, DC-DC Converter, Battery 관리시스템)
	M-Healthcare	- 생체신호 센싱 알고리즘, 저전력/고효율 Digital 회로 설계
4. 기반설계		
	Design Technology	- Library, DFT, PD/Low Power(STA/Leakage 해석/최적화), Timing(Clock Mesh 해석/최적화) - In-House Tool개발, EMI/RFI/Mixed SI, FPGA/Emulator, 검증(Formal)
	Mixed Signal Core	- High-Speed SAR ADC, TDC/PLL Low Power IP, High Accurate/Digitalized Temperature Sensor, Regulator/Buck/Charger
	Digital IP	- Security(PUF IP), LINK(Uni Pro), PHY(10Gbps, 4Gbps DRAM I/F), Validation
	ESD, TCAD	- 공정에 대한 ESD 특성분석 및 개선을 위한 ESD/TCAD 동시 경험

5. Foundry		
	마케팅	- 차세대 공정 Define, 공정 Roadmap, 전략수립, 기술대응
	상품기획	- PDK, Modeling, Serdes IP Integration
	Process Architecture	- Advanced Logic 공정의 BEOL Integration 및 Reliability 전문가 - GRV(Ground Rule Verification), DFM 및 Process Control 기술 경험자 - RF Device Evaluation 및 Characterization 전문 기술 확보. RF CMOS 및 Mixed Signal 소자 기술 확보
	LSI Technology Development	- CMOS Image 센서 공정, CMOS Pixel 소자 전문가 - HV Analog Device
6. 제조		
	기술	- Photo (Overlay, Aerodynamic Electromagnetic simulation) - Etch (Simulation, Module) - CMP (Defect 제어, Material 개발 경험) - Clean (Cu Void 제어, Clean COR설비 식각산포 개선, Defect제어) - Diffusion (HKMG, SiGe) - CVD (Low K Film 두께 산포 및 Defect 제어) - Metal (ALD 공정 두께 산포 Control 및 Defect 제어)
	YE	- Metrology (New Material & Process Metrology Solution 개발) - 분석 (SEM, TEM, STEM, EELS, APT) - 소재 (Package, Wafer, Chemical) - Device & Process (Transistor 특성확보, 불량분석) - Defect, eSiGe, EPI
	품질	- 10nm 공정노드에서의 SER평가, SER 모델링 및 벤치마킹 - Circuit Reliability, TEG design 및 신뢰성 모델링 - 소자 Reliability CAD - Flexible Package electronics - Excursion/Claim주요이슈 대응을 위한 표면 분석